



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090924000A  
2011 年 1 月 11 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタムドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 

ASP 一部製品 Backend前処理サイト追加変更のご案内

(認定済 46 製品への追加認定 13 製品の連絡)

(初版 PCN20090924000 2009 年 9 月 30 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **180** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	下記変更について認定済46製品への追加認定13製品の連絡になります。 ASP 一部製品 Backend前処理サイト追加変更 現行 : TI-DMOS5 (Dallas, 米国) 変更後 : TI-DMOS5 (Dallas, 米国)、SMIC社(中国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は7月下旬の出荷より予定しています。 (追加認定品のサンプルは2月下旬の出荷より予定しています。) 認定終了品は2010年1月上旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し		<input type="checkbox"/> 変更あり	
備考	-			

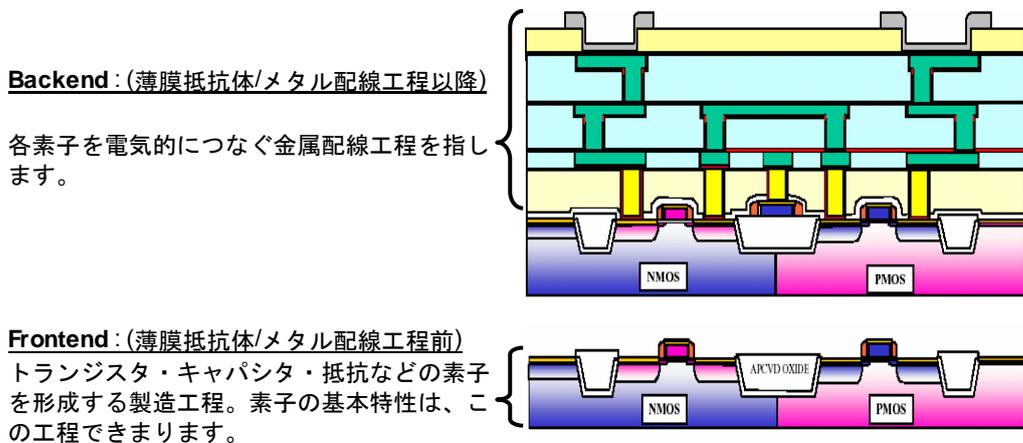
変更内容

内容 : 今回のお知らせは、下記変更について認定済46製品への追加認定13製品の連絡になります。弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト) 一部製品のBackend前処理サイトについて、現行 TI-DMOS5 (Dallas, 米国) サイトにて製造していますが、セカンドソース前処理サイトによる安定供給能力確保の為に、これに加えて、SMIC社(中国)サイトを追加し認定しました。SMIC社は弊社認定済みの前処理サイトになります。本変更は、Backend前処理サイトのみの追加変更で、Frontend前処理サイトについては、現行 TI-DMOS5サイトに变更ありません。Backend/Frontend前処理工程の違いについては下記を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容  
Backend前処理サイト

現行  
TI-DMOS5 (Dallas, 米国)

変更後  
TI-DMOS5 (Dallas, 米国)  
SMIC社(中国)



理由 : セカンドソース前処理サイトによる安定供給能力確保の為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名				
■:追加認定品 □:認定終了品				
D610A003BPYP225	D708E002BRFP266	D788E001BRFP266L	SP6727BZDH3DABTE	TMS320C6727BZDH250
D610A003BPYP225C	D70YE101BRFP266	D788E001BRFP266S	SP6727BZDH3DBT	TMS320C6727BZDH275
D705E001BRFP250	D710E001BGDH300	D788E001BRFP266Z	SP6727BZDH3DBTE	TMS320C6727BZDH300
D705E001BRFPA250	D710E001BGDHA275	D788E001BRFPA250	SP6727BZDH3M	TMS320C6727BZDH350
D705E002BRFP250	D710E001BZDH275	D788E002BRFP266	SP6727BZDH3MA	TMS320C6727BZDHMUD
D707E001BRFP250	D710E001BZDH300	D790E001BZDH275	TMS320C6720BRFP200	TMSC6727BZDH300TAN
D707E001BRFP250Z	D710E001BZDHA275	D790E001BZDH300	TMS320C6722BRFP200	TMSC6727BZDH350TAN
D707E001BRFPA250	D710E002BZDHA275	D790E001BZDH300Z	TMS320C6722BRFP250	TMSDC6722BRFPA225
D708E001BRFP266	D787E001BRFP250	D790E002BZDH300	TMS320C6726BRFP266	TMSDC6726BRFPA225
D708E001BRFP266M	D787E001BRFP250L	SP6727BZDH3D	TMS320C6727BGDH275	TMSDC6727BGDHA250
D708E001BRFP266Z	D787E001BRFPA250	SP6727BZDH3DA	TMS320C6727BGDH300	TMSDC6727BZDHA250
D708E001BRFPA250	D788E001BRFP266	SP6727BZDH3DABT	TMS320C6727BGDH350	

製品表示

今回の変更は、Backend前処理サイトのみの追加変更で、Frontend前処理サイトについては、現行TI-DMOS5 サイトに変更ありませんので、前処理サイトを示す製品捺印上の前処理サイトコードについて、TI-DMOS5 サイトを示す“C”に変更はありません。

信頼性試験

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	—	終了 2007年3月19日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Device:	TMS320SP6727RFP Rev 1.1	Wafer Technology:	1233C035.A6
Wafer Fab:	DM5 Frontend / SMIC Backend	-	-
Assembly Site:	TAI	Package Code/Pins:	RFP/144
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
**Temp Cycle	-55/125C, 1000cyc	231/0	
**Storage Bake	150C, 1000 Hours	231/0	
**Temp Humidity Bias	85%RH / 85C, 600 Hours	231/0	
**Thermal Shock	-55/125C, 200cyc	156/0	
**Autoclave	121C, 96 Hours	231/0	
Early Life failure (EFR) assessment	48 hours, 125C dynamic Burn-in.	2528/0	
HTOL	Q100 Grade2, 125C, 408 hours	598/0	
ESD -HBM	2.0 kV	9/0	
ESD -CDM	500V	9/0	
CMOS Latch-up	100mA & 1.5 x Vmax, 90C	15/0	
Manufacturability	per mfg. site specification	Approved	
Electrical Characterization	Per characterization plan	Approved	
Notes: ** Indicates test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-4/260C			

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	—	終了 2007年3月19日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Device:	TMS320SP6727ZDH Rev 1.1	Wafer Technology:	1233C035.A6
Wafer Fab:	DM5 Frontend / SMIC Backend	-	-
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	ZDH(GDH)/256
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
**Temp Cycle	-55/125C, 1000cyc	78/0	
**Unbiased HAST	110C/85%RH, 288 Hours	78/0	
**Thermal Shock	-55/125C, 200cyc	78/0	
ESD -HBM	2.0 kV	9/0	
ESD -CDM	500V	9/0	
CMOS Latch-up	100mA & 1.5 x Vmax, 90C	15/0	
Manufacturability	per mfg. site specification	Approved	
Notes: ** Indicates test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-3/260C			